

9,500億ドルの衝撃：米韓AI・半導体同盟の始動と日本産業界への波及効果

米韓の巨大テクノロジー企業による歴史的なAI半導体協定の全貌と、それが日本の製造装置・材料メーカー、および先端ファウンドリ構想に与える多角的な影響を可視化する。

米韓「超大型AI同盟」の構造と規模

主要な提携主体と契約規模の視覚化

SKグループ × NVIDIA

5,000億ドル超 (LOI)

HBM4共同開発、
2GW級AIファクトリー建設

サムスン × ブロードコム

2,000億ドル経 (MOU)

2nm以下ファウンドリ、
先端パッケージング

SKハイニックス × 米テック

7,500億ドル (供給契約)

HBMを含むAIメモリの
超長期優先供給

9,500億ドル
(約155.7兆円)

歴史的投資

三位一体統合

メモリ・製造・DC

メモリ

製造

DC

次世代HBM4の
共同開発

2nm最先端
ファウンドリ受託

GW級AI
データセンター建設

日本産業界への二面的な波及効果



装置・材料メーカーへの
「絶対的特需」

HBM4量産に不可欠なディスコ(研削)、アドバンテスト(検査)、レゾナック(材料)等の需要が爆発。

装置カテゴリ別の主要プレイヤー



東京エレクトロン
(研工程)



SCREEN
(洗浄)



信越化学
(EUVレジスト)



国内先端ファウンドリ(Rapidus)
への挑戦状

サムスンがブロードコムの2nm受注を先行確保したことで、顧客獲得競争の激化が不可避に。

サムスン・ブロードコム

2nm受注先行確保



Rapidus